

证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2026-017

广东依顿电子科技股份有限公司 关于投资建设高端印制电路板智能制造项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：高端印制电路板智能制造项目（以下简称“项目”或“本项目”）。

● 投资金额：项目计划总投资 297,877.93 万元（最终以项目建设实际投资为准）。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次投资事项尚需提交股东会审议。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：

1、本项目尚需完成环境影响评价、节能审查等法定审批程序，审批进度及结果存在不确定性；若审批延期或未能顺利获批，将直接影响项目开工、建设及投产进度。

2、下游应用行业技术迭代快、市场竞争激烈，若宏观经济波动、行业政策调整、市场需求不及预期或产品价格出现波动，以及工艺调试、设备运行未达预期，均可能影响产能释放与项目预期效益。

3、项目资金投入规模较大、建设周期较长，本项目投资可能导致广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）资产负债率有所提升，财务压力相应增加；若融资环境发生变化、客户拓展及订单落地不及预期，还可能面临融资成本上升、产能无法充分消化等风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为增强公司的核心竞争力，提升公司可持续发展能力，公司拟使用自有资金及自筹资金 297,877.93 万元投资建设“高端印制电路板智能制造项目”。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☐ 新设公司 ☐ 增资现有公司（ ☐ 同比例 ☐ 非同比例） --增资前标的公司类型： ☐ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☒ 投资新项目 ☐ 其他：_____
投资标的名称	高端印制电路板智能制造项目
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）： <u>297,877.93</u> （最终以项目建设实际投资为准） ☐ 尚未确定
出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金 ☒ 募集资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他：_____
是否跨境	☐ 是 ☒ 否

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准

公司于 2026 年 8 月 5 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资建设高端印制电路板智能制造项目的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金 297,877.93 万元投资建设高端印制电路板智能制造项目。

本事项尚需提交股东会审议。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

本项目投资主体为广东依顿电子科技股份有限公司。投资项目主要围绕市场高端印制电路板需求，建设高端高速高多层 PCB 智能制造项目。项目拟利用依顿电子中山现有园区土地，新建专业化生产厂房，配套实施基建工程、厂房装修、设备购置安装、公辅配套、废水处理、危化品安全管理、仓储物流及数字化管理系统建设，形成面向高端算力硬件的印制电路板规模化制造能力。

（二）投资项目的具体信息

1、项目基本情况

投资类型	☒ 投资新项目
项目名称	高端印制电路板智能制造项目
项目主要内容	围绕市场高端印制电路板需求，建设高端高速高多层 PCB 智能制造项目
建设地点	广东依顿电子科技股份有限公司中山现有园区内
项目总投资金额（万元）	297,877.93（最终以项目建设实际投资为准）
上市公司投资金额（万元）	297,877.93（最终以项目建设实际投资为准）
项目建设期（月）	21
预计开工时间	2026/12/01
预计投资收益率	13.01%（税后）
是否属于主营业务范围	☒ 是 ☐ 否

2、各主要投资方出资情况

本次项目投资所需资金全部来源于公司的自有资金和自筹资金获得。

3、项目目前进展情况

本次投资建设项目目前处于初期筹备阶段，尚未开始建设。

4、项目市场定位及可行性分析

本项目产品定位于高端印制电路板，产品结构以高多层板（HLC）和高阶高密度互连板（HDI）为主，项目产品主要服务服务器、高速交换机、路由器、加速卡、计算托盘主板以及通信设备等核心算力硬件，重点满足高带宽、低损耗、高密度互连、高可靠运行和长期稳定交付等应用需求。总体来看，本投资项目建

设方向明确，市场需求具备支撑，产品定位清晰，建设条件成熟，技术和运营方案具有可实施性，财务测算结果具备一定投资回报基础，风险总体可识别、可管控。项目实施有助于公司提升高端 PCB 制造能力，优化产品和客户结构，增强企业在算力、高速通信及高端电子装备配套领域的综合竞争力。综合判断，本投资项目具备推进实施的可行性。

（三）出资方式及相关情况

本次对外投资的资金全部来源于公司自有和自筹资金，不存在损害公司及其他股东的合法利益的情形。

三、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资项目围绕公司 PCB 主业开展，符合公司长期发展战略。随着项目的稳步推进与实施，本项目预计将进一步完善公司高端产品布局，增强公司经营实力与盈利能力，对公司未来业务发展和经营效益产生积极影响。

本次项目资金来源于公司自有资金及自筹资金，项目投资规模及资金安排不会对公司正常生产经营、财务状况及现金流造成重大不利影响。本次投资不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、风险提示

1、本项目尚需完成环境影响评价、节能审查等法定审批程序，审批进度及结果存在不确定性；若审批延期或未能顺利获批，将直接影响项目开工、建设及投产进度。

2、下游应用行业技术迭代快、市场竞争激烈，若宏观经济波动、行业政策调整、市场需求不及预期或产品价格出现波动，以及工艺调试、设备运行未达预期，均可能影响产能释放与项目预期效益。

3、项目资金投入规模较大、建设周期较长，本项目投资可能导致公司资产负债率有所提升，财务压力相应增加；若融资环境发生变化、客户拓展及订单落地不及预期，还可能面临融资成本上升、产能无法充分消化等风险。

公司将密切跟踪审批及行业动态，强化项目建设、生产运营及市场拓展管理，

积极落实各项应对举措，全力保障项目平稳推进。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 7 日